

烟台德邦科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更募投项目实施主体、实施地点：

1、年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目由“德邦（苏州）半导体材料有限公司实施，实施地点：苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧”变更为由“四川德邦新材料有限公司实施，实施地点：四川彭山经济开发区产业大道 12 号”；

2、新建研发中心建设项目由“德邦（苏州）半导体材料有限公司实施，实施地点：苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧”变更为由“德邦（昆山）材料有限公司实施，实施地点：昆山市千灯镇朱家山路西”。

● 调整募投项目投资金额：

1、年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目投资总额由 13,361.88 万元变更为 6,241.99 万元，募集资金拟投资金额由 11,166.48 万元变更为 6,241.99 万元；

2、新建研发中心建设项目投资总额由 17,906.43 万元变更为 17,690.85 万元，募集资金拟投资金额由 14,479.23 万元变更为 17,690.85 万元。

3、年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目调减募集资金拟投资金额 4,924.49 万元，其中 3,211.62 万元拟用于上述新建研发中心建设项目的追加投资，剩余部分 1,712.87 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出

其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

● 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556万股，每股面值1.00元，每股发行价格46.12元。本次公开发行募集资金总额为人民币164,002.72万元，扣除发行费用15,254.40万元（不含增值税），实际募集资金净额为148,748.32万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]第210029号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金	截止2022年末已投入募集资金
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	31,793.18
2	年产35吨半导体电子封装材料建设项目	13,361.88	11,166.48	0.00
3	新建研发中心建设项目	17,906.43	14,479.23	0.00
	合计	70,001.79	64,379.19	31,793.18

三、本次变更部分募投项目情况

（一）年产35吨半导体电子封装材料建设项目

1、变更募投项目的具体原因

经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，公司拟将年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目的实施主体变更为子公司四川德邦新材料有限公司，与该实施主体现有的新能源及电子信息封装材料建设项目共同实施，充分利用其土地及公辅工程、设施、设备及配套建筑等，优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，更有利于公司生产经营管理。变更后年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目可大幅节约相关投资，投资总额由 13,361.88 万元变更为 6,241.99 万元，拟投入募集资金由 11,166.48 万元变更为 6,241.99 万元，调减金额为 4,924.49 万元，其中 3,211.62 万元拟用于上述新建研发中心建设项目的追加投资，剩余部分 1,712.87 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

2、本次变更募投项目的具体情况

项目名称	变更事项	变更前	变更后
年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	实施主体	德邦（苏州）半导体材料有限公司	四川德邦新材料有限公司
	实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧	四川彭山经济开发区产业大道 12 号
	投资总额（万元）	13,361.88	6,241.99
	拟投入募集资金（万元）	11,166.48	6,241.99

3、变更后实施主体基本情况

主体名称	四川德邦新材料有限公司
统一社会信用代码	91511422MAC89A6B0K
成立日期	2023 年 2 月 16 日
法定代表人	陈田安
注册资本	人民币 10000 万元
注册地址	四川彭山经济开发区产业大道 12 号
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化

	学品)；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	--

4、募投项目内部投资结构调整情况

单位：万元

项目类别	调整前	调整后
一、建设投资	11,791.45	5,174.54
1 工程费用	9,801.67	4,984.96
1.1 厂房建造费用	6,279.94	2,160.00
1.2 设备购置费	3,419.16	2,742.68
1.3 设备安装费	102.57	82.28
2 工程建设其他费用	1,815.52	88.12
3 预备费用	174.26	101.46
二、铺底流动资金	1,570.44	1,067.45
合计	13,361.88	6,241.99

(二) 新建研发中心建设项目

1、变更募投项目的具体原因

为加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，经综合考虑募集资金投资项目实际情况，公司拟将新建研发中心建设项目的实施主体变更为德邦（昆山）材料有限公司，并相应调整募投项目投资金额。本次变更后新建研发中心建设项目投资总额由 17,906.43 万元变更为 17,690.85 万元，拟投入募集资金由 14,479.23 万元变更为 17,690.85 万元，差额部分 3,211.62 万元拟使用年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目调减资金。

2、本次变更募投项目的具体情况

项目名称	变更项	变更前	变更后
新建研发中心建设项目	实施主体	德邦（苏州）半导体材料有限公司	德邦（昆山）材料有限公司
	实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧	昆山市千灯镇朱家山路西

	投资总额 (万元)	17,906.43	17,690.85
	拟投入募集资金 (万元)	14,479.23	17,690.85

3、变更后实施主体基本情况

主体名称	德邦（昆山）材料有限公司
统一社会信用代码	91320583MA25A9JD1J
成立日期	2021年3月2日
法定代表人	解海华
注册资本	人民币10000万元
注册地址	昆山市千灯镇石浦汶浦东路216号
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料销售；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、募投项目内部投资结构调整情况

单位：万元

项目类别	调整前	调整后
一、建设投资	17,906.43	17,690.85
1 工程费用	16,705.63	15,559.34
1.1 研发建筑建造及装修费用	8,503.20	11,462.34
1.2 设备购置费	8,000.00	3,977.67
1.3 设备安装费	202.43	119.33
2 工程建设其他费用	849.70	1,784.62
3 预备费用	351.11	346.88
二、铺底流动资金	0.00	0.00
合计	17,906.43	17,690.85

四、本次变更部分募集资金投资项目的影

本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点及调整募投项目投资金额等相

关事项，系公司基于推进募投项目建设和保障其有效实施的需要，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，可以更好地满足公司发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

2023年4月14日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，该事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的业务发展的需要和长远战略。变更募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范畴，且具有良好的市场前景，对提升公司核心竞争力具有积极作用，有利于公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司本次变更募投项目，并同意将该事项相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募投项目，是基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，为提高募集资金使用效率，充分利用公司现有募投项目实施主体及场地，本次变更不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策程序符合相关法律法规的规定。因此，一致同意本次变更事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目相关事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合公司业务发展的需要，有利于提高公司募集资金

使用效率，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

保荐机构对公司本次变更部分募投项目相关事项无异议。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日